

柏騰科技 (3518)

法人說明會

日期：2025 / 12 / 02

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運展望、財務狀況及業務預測等內容，係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。
- 本公司未來實際產生的營運結果、財務狀況與業務成果，可能與預測性資訊有所差異，其原因可能來自各種因素，包括但不限於市場需求、各種政策法令與整體經濟現況之改變，以及其他本公司無法掌控之風險等因素。
- 本簡報中所提供之資訊，係反應本公司截至目前為止對於未來的看法，並未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於簡報內容，未來若有任何變更或調整，本公司不負責更新或修正。

大綱

CONTENTS

01

公司簡介

Company Overview

02

財務資訊

Financial Information

03

進度報告

progress report

04

營運展望

Operating status

05

資訊交流

Q&A



公司簡介

Company Overview

柏騰科技(3518)

柏騰科技（台灣證券交易所 | 股票代號3518）成立1995年，為全球首家將真空鍍膜(PVD)技術應用在3C產品的EMI/ESD解決方案，近年積極轉型開發第三代半導體材料及先進製程技術，為業界少數同時具備生產碳化矽基板、真空鍍膜技術與製程開發的公司。

- ◆ 成立時間：84.10.20
- ◆ 資本額：97,887萬元
- ◆ 董事長：黃逸駿
- ◆ 總經理：游秀屏
- ◆ 目前主要產品及其應用：
 - 真空鍍膜(PVD) – 佔比99%
 - 碳化矽 (SiC) – 佔比 1%

關於柏騰



台灣總部&研發中心

- 成立時間：1995年
- 資本額：9億7仟萬
- 台灣桃園市&中國蘇州



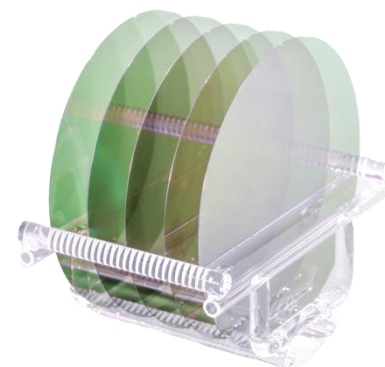
真空鍍膜(PVD)產品

防EMI&外觀鍍膜服務

- 南京廠/內江廠 (PVD鍍膜&設備)

種子層(Seed layer)PVD製程設備

散熱基板薄膜服務



碳化矽(SiC)產品

6~8吋碳化矽(SiC)晶圓

- 導電型(N-Type/P-Type)
- 半絕緣型(HPSI)
- 碳化矽散熱應用
- 晶錠加工&再生晶圓

12吋碳化矽晶圓(開發中)

發展歷程

柏騰為全球首家將真空鍍膜(PVD)技術應用在3C產品的EMI/ESD解決方案，目前為NB防EMI最大供應商，2022年併購晶成材料擁有SiC(碳化矽)基板生產技術並進入第三代半導體供應鏈，2025年12月嘉義8吋SiC基板新廠完工，為業界少數同時具備碳化矽基板製造、真空鍍膜技術與製程開發的公司，在未來AI應用中碳化矽已成為未來半導體製程中最重要的材料，柏騰將結合碳化矽材料與真空鍍膜技術的優勢取得領先機會。





財務資訊

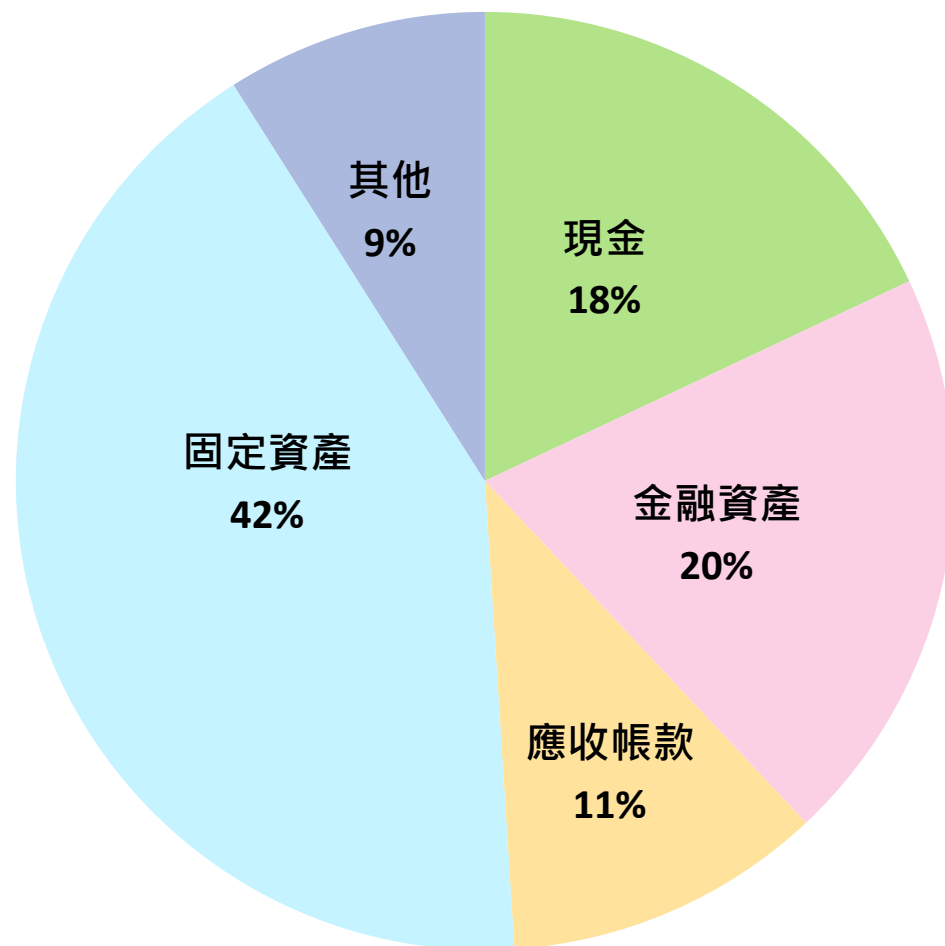
Financial Information

2025年第三季合併資產負債表

單位:新台幣佰萬元

	2025.9.30	%	2024.12.31	%	2024.09.30	%
現金及約當現金	383	18	1,069	49	1,212	54
金融資產-流動&非流動	421	20	228	10	228	10
應收帳款及票據	234	11	246	11	265	12
存貨	13	1	20	1	19	1
待出售非流動資產	10	0	10	0	10	0
固定資產及使用權資產	896	42	413	20	378	17
其他資產	164	8	196	9	145	6
資產總計	2,121	100	2,183	100	2,257	100
短期及一年內到期借款	225	11	171	8	211	10
其他應付款	77	4	114	5	76	3
應付公司債	289	13	284	12	283	13
長期借款	69	3	15	1	31	1
其他負債	137	6	144	7	156	7
負債總計	796	38	729	33	756	34
權益總計	1,325	62	1,455	67	1,501	66
每股淨值	13.57		15.00		15.48	

財務結構與比率



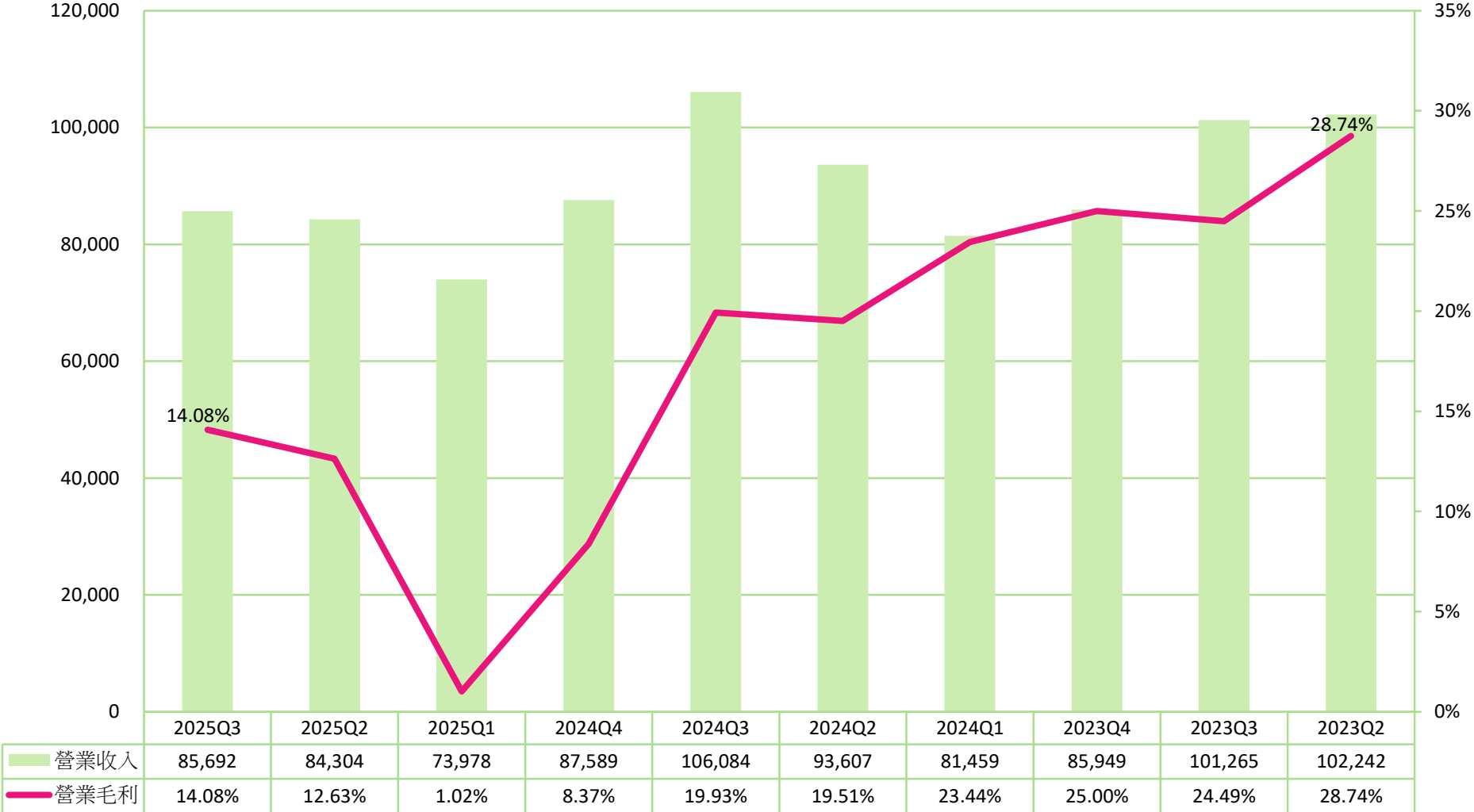
項 目	2025年Q3	2024年	2023年	2022年	2021年
負債比率	37.53	33.37	21.49	16.30	24.54
流動比率	332.72	511.45	395.27	606.50	377.86
現金流量比率	(66.04)	(33.46)	(17.17)	63.32	31.54

2025年第三季合併綜合損益表

單位:新台幣佰萬元

項目	2025年第三季	2025年第二季	增減	2024年第三季	增減
營業收入	86	84	2	93	(7)
營業毛利	12	11	1	12	(0)
營業費用	45	49	(4)	69	(24)
營業淨利(損)	(33)	(39)	6	(57)	24
營業外收支	34	42	(8)	(4)	38
繼續營業單位稅前淨利	1	4	(3)	(61)	62
所得稅費用	4	0	4	2	2
繼續營業單位本期淨利(損)	(3)	4	(7)	(63)	59
停業單位淨利(損)	1	1	0	(1)	2
本期淨損	(3)	4	(7)	(64)	62
毛利率(%)	14%	13%		13%	
純益率(%)	-3%	5%		-69%	
每股盈餘(元)	(0.03)	0.04		(0.68)	

收入與毛利率趨勢圖



2025年第三季合併現金流量表

單位:新台幣佰萬元

	2025年1月1日 至9月30日	2024年1月1日 至9月30日
營業活動之淨現金流入(出)	(222)	(96)
投資活動之淨現金流入(出)	(529)	(226)
籌資活動之淨現金流入(出)	95	692
匯率變動對現金及約當現金之影響	(30)	40
本期現金及約當現金增(減)數	(686)	411
期初現金及約當現金餘額	1,069	801
期末現金及約當現金餘額	\$383	\$1,212

重要事件說明

- ◆ 114年第1次私募普通股完成股款繳納暨增資基準日, 本次實際私募增資普通股為5,000仟股已收足股款, 增資基準日為114年11月20日。(114.11.19)
- ◆ 董事會決議辦理私募普通股定價, 訂定20元為本次實際私募價格, 本次私募股數5,000,000股, 募集金額新台幣100,000,000元。(114.11.05)
- ◆ 董事會通過114年度第三季合併財務報表, 114年度累計基本每股損失新台幣0.93元。(114.11.05)
- ◆ 子公司精華國際投資有限公司解除原出售柏靈(蘇州)光電科技有限公司之股權轉讓協議。(114.10.17)
- ◆ 重要子公司柏靈(江蘇)光電科技有限公司公告決議辦理現金減資美金2,500,000元。(114.09.02)
- ◆ 董事會通過114年度第二季合併財務報表, 114年度累計基本每股損失新台幣0.90元。(114.08.06)
- ◆ 重要子公司柏騰(內江)光電科技有限公司決議發放股利人民幣8,551,804.26元。(114.06.25)



進度報告

progress report

SiC新廠計劃

- ◆ 建廠預算：新台幣 89,953 萬元(一期)
- ◆ 新廠位置：嘉義大埔美智慧型工業園區
- ◆ 主要產品：8吋SiC晶圓
- ◆ 一期產能：3,000pcs/月 二期產能:6,000pcs/月
- ◆ 2026年加工產能：6,000pcs/月

2024H2
(建置期)

ISO9001及14001認證
通過目標客戶認證
開始建置新廠廠務及工程
導入先進8吋長晶製程設備，縮短製程開發時間

2025
(新廠啟用)

~~Q1-Q3~~廠務工程完工
~~Q2-Q4~~設備安裝
~~Q3-Q4~~試量產準備
~~Q4~~**2026Q1**新廠啟動
開發半絕緣產品
- SiC散熱基板
- 12吋SiC基板(開發中)

2026
(一階段)

IATF 16949認證
通過目標客戶認證
年產能24,000pcs
6~8吋SiC基板
6~8吋SiC加工服務
SiC晶圓再生服務
SiC散熱基板

2027
(二階段)

通過車用認證
年產能36,000pcs
進行新廠二期擴產準備
最大年產能72,000pcs
12吋SiC散熱材料
(先進封裝)

新廠進度說明

● 廠務工程進度100%

廠務工程於2025年9月完工，10月開始進行廠務8大系統運行測試及驗收。目前進行竣工及環評申請，預計2026年Q2取得工廠登記證。

● 產能設備建置進度80%

加工設備已全部到廠進行安裝中，預計12月中安裝完畢，2026Q1完成製程調試，2026Q2正式量產。

● 產品驗證進度

8吋產品-多家客戶進行製程驗證中，預計2026年導入量產。

SiC散熱基板-已進行小批量驗證，預計2026年導入量產。

● 業務開發進度

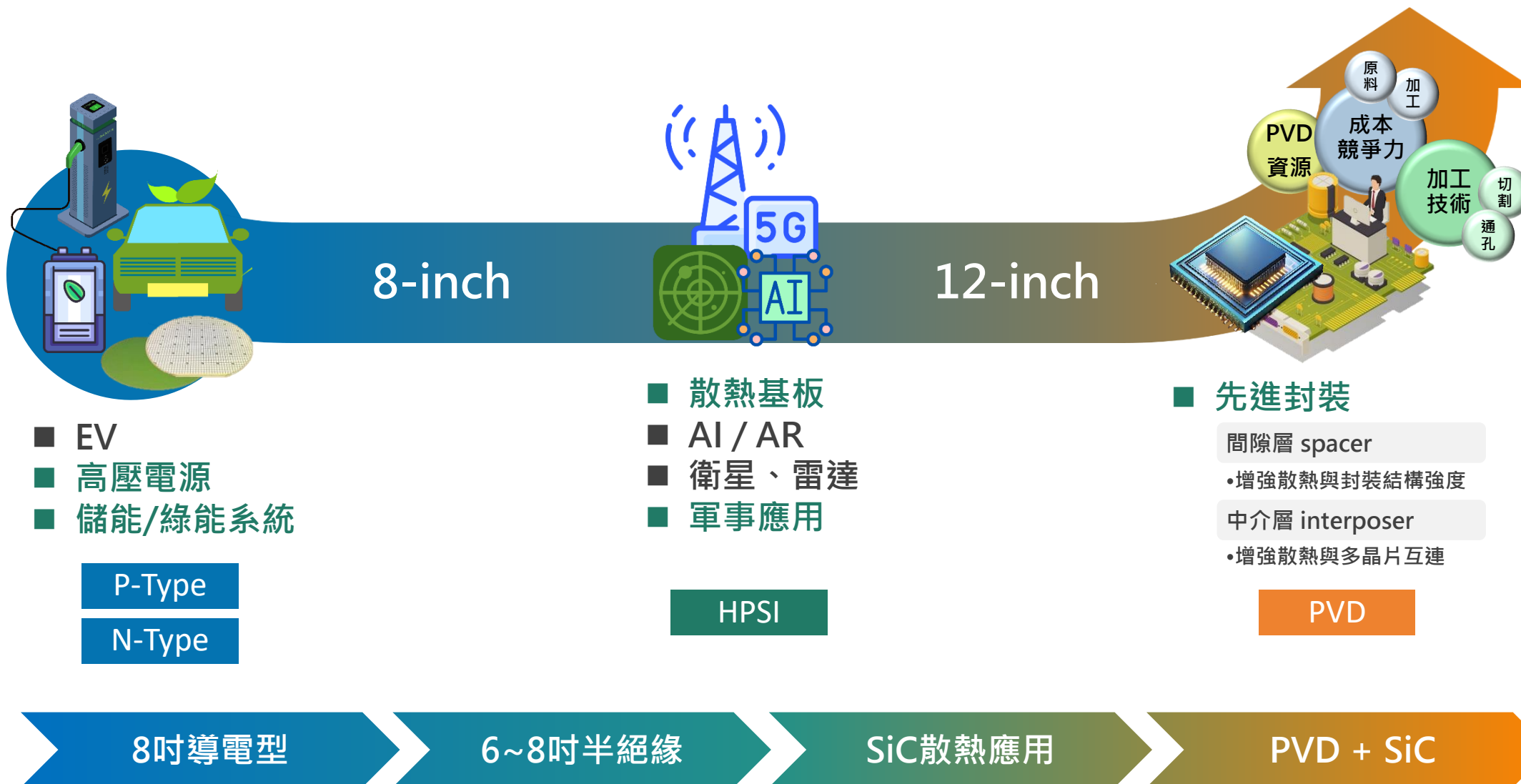
6~8吋SiC基板銷售
6~8吋SiC基板加工服務
6~8吋SiC晶圓再生服務
SiC散熱應用 (SiC&PVD)



營運展望

Operating status

產品發展方向



營運展望

EMI鍍膜產品

整體經濟疲軟與關稅風險升溫，預估2026年筆電品牌全年出貨年增率約3%，因中美關稅成本風險迫使品牌採取更保守的生產與採購策略，短期輸美市場產品產能在今年加速移出中國大陸，使中國EMI訂單受到影響，2026年仍需持續觀察對於中國市場營運的影響程度。

PVD鍍膜技術

真空濺鍍(PVD)鍍膜技術應用範圍相當廣泛，尤其為符合ESG及環保減碳的趨勢潮流下，將PVD鍍膜技術應用在功能鍍膜及外觀表面處理。

(1)AF鍍膜 - NB產品

(2)類陽極鍍膜 - NB、3C產品

(3)功能鍍膜 - 散熱膜、先進封裝重佈線路(RDL)、金屬種子層 (Seed layer)、晶背金屬化等。

SiC晶圓產品

全球8吋晶圓廠將陸續開始量產，研調機構預估2028年6吋晶圓需求佔比將達到1:1，8吋SiC晶圓年均成長率(CAGR)可望達到18.5%。

單晶SiC基板在高導熱材料中具有良好的導熱能力，目前半導體大廠積極開發SiC散熱材料的應用，未來將進一步擴大整體SiC材料需求。

SiC加工服務

(1)6~8吋晶錠加工

(2)SiC再生晶圓(Reclaim)

(3)SiC散熱基板及減薄服務

新廠具備晶體加工產能，加工月產能可達7200片，就近提供國內6吋及8吋長晶廠晶圓加工及磊晶廠SiC再生晶圓(Reclaim)服務。



資訊交流

Q&A

TRUE PARTNER FOR A BRIGHTER FUTURE



發言人：劉明怡 財務處副總

電話：(03)212-8833

E-mail：mingi@pttech.com.tw.